

NEXTY ELECTRONICS WORLD

vol.176 JUL 2019

特集企画：NXPセミコンダクターズ社

共にビジネスを創造してきた30年来のパートナー NXPセミコンダクターズ
オートモーティブ向けマイコン ～S32x Automotive Processing Platform～
i.MX 8M Miniシリーズ ～高性能、低価格なアプリケーションプロセッサ～
LPCシリーズ・Kinetisシリーズ・i.MX RTマイコン ～幅広いラインナップのArmコアマイコン～
NFC準拠NTAG12C Plus(NT3H21xx)及び各種RFIDタグIC
RFIDモジュール





Be the Next Bridge to the Future

表紙：バヌアツ サント島のブルーホール(写真は社内公募の中から選ばれた作品です)

CONTENTS

特集企画：NXPセミコンダクターズ社

- 共にビジネスを創造してきた30年来のパートナー NXPセミコンダクターズ社 ————— 3
- オートモーティブ向けマイコン ～S32x Automotive Processing Platform～ ————— 4
- i.MX 8M Miniシリーズ ～高性能、低価格なアプリケーションプロセッサ～ ————— 5
- LPCシリーズ・Kinetisシリーズ・i.MX RTマイコン ～幅広いラインナップのArmコアマイコン～ ————— 6
- NFC準拠NTAG12C Plus (NT3H21xx) 及び各種RFIDタグIC ————— 7
- RFIDモジュール ————— 8

新製品

- NVIDIA社 自動運転システムソリューション & Jetson新製品紹介 ————— 9
- Infineon Technologies AG社 最新! CoolMOS P7シリーズのご紹介～各耐压ラインナップが揃いました～ ————— 10

注目製品

- Maestro Wireless Solutions社 IoT/M2Mのゲートウェイとして最適な通信端末のご紹介 ————— 11・12

ディスクリート

- VISHAY社 車載向けIHL 5050/6767サイズの新製品発表 ————— 13

汎用

- Maxim Integrated社 nanoPower バックコンバーターMAX38640のご紹介 ————— 14

取組紹介

- 自動運転基本ソフトウェアAutowareと連携可能なMATLAB®/Simulink®サンプルを公開 ————— 15
- ネクスティ エレクトロニクスとモデルベース開発ツールベンダーのETASが業務提携 ————— 16
- ネクスティ エレクトロニクスとBlackBerry QNXのVAIパートナー契約を締結 ————— 16
- 豊田通商先端電子(大連)とC&S Group GmbHが日系グループ企業として初めて中国CATARCグループと合併会社を設立 — 17
- ネクスティ エレクトロニクスと半導体製造中止品の継続供給サポートを行うRochester Electronics, LLCが代理店契約を締結 — 18

新拠点紹介

- ネクスティ エレクトロニクス2019年上半期新拠点のご紹介 ————— 19

製品MATRIX ————— 20

取扱い製品一覧 ————— 21

NXP セミコンダクターズ社

共にビジネスを創造してきた30年来のパートナー NXPセミコンダクターズ

組込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPセミコンダクターズ（以下、NXP）は、60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー保護、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。

NXPの会社概要

■ 本社

正式名称：NXP Semiconductors N.V.
 本社所在地：アイントホーフェン（オランダ）
 設立：2006年8月1日
 従業員数：約3万人（世界約30ヶ国）
 事業領域：オートモーティブ、インダストリアル&IoT、
 通信インフラ、モバイル
 売上高：\$9.41B（CY2018）
 海外事業拠点：オランダ、中国、米国、シンガポール、他
 URL：<https://www.nxp.com/>

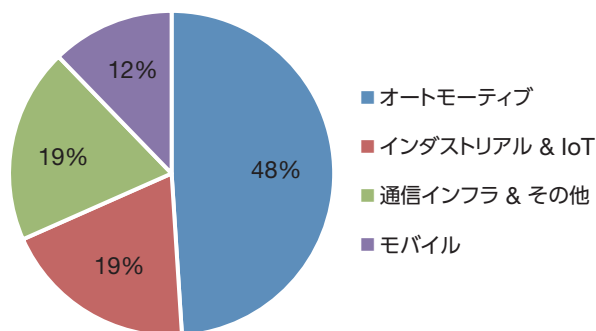
■ 日本法人

社名：NXPジャパン株式会社
 本社所在地：東京
 設立：2006年8月1日
 営業所：名古屋、大阪
 代表取締役社長：原島 弘明
 URL：<https://www.nxp.jp/>

■ NXP沿革

2006年 8 月 PHILIPSセミコンダクターズが半導体部門を投資家グループに売却
 2010年 5 月 社名を現在のNXPセミコンダクターズN.V.に変更
 2015年12月 フリースケール・セミコンダクターとの現在合併のNXPセミコンダクターズが誕生

■ NXP売上構成比（CY2018売上\$9.41B）



NXPとネクスティ エレクトロニクスの歩み

ネクスティ エレクトロニクスでは30年超の長きに渡り、NXP前身のPHILIPSセミコンダクターズ時代から共に歩んできました。

現在ネクスティ エレクトロニクスでは、NXP注力市場向け製品群を中心に当社のエンジニアリングサポートをはじめ、サードパーティーソリューション、各種モジュール開発、ソフトウェア開発支援、品質サポート等幅広い機能を提供しています。また、新たに技術者様向けにe-NEXTYポータルサイトを活用いただくなど、より一層お客様の開発支援を前へ推進していきます。



URL：<https://www.e-nexty.com>



NXP 注力市場/製品群



お問い合わせ先／プロダクトマーケティングユニット NXPグループ nxp@nexty-ele.com



NXP セミコンダクターズ社

オートモーティブ向けマイコン ～S32x Automotive Processing Platform～

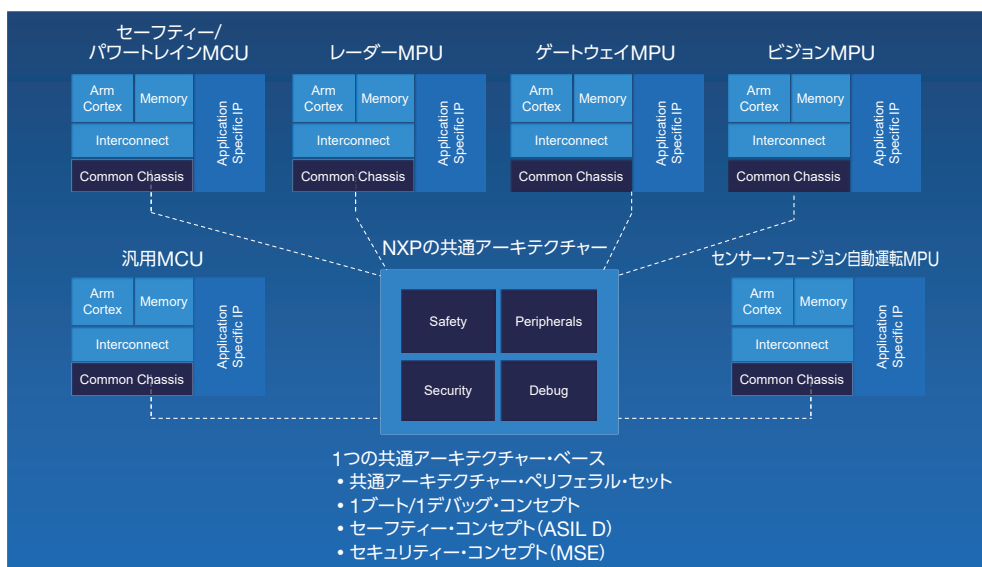
オートモーティブプロセッシング向けの新しいプラットフォームとしてS32xシリーズでは、さまざまなMCUやMPUに共通する部分のアーキテクチャを提供します。信頼性や機能安全、セキュリティを満たすことが可能となりうる低消費電力のARM Cortex-Mやリアルタイム処理向けのARM Cortex-R、高性能のARM Cortex-AがベースのMCUやMPUをこのアーキテクチャは取り揃えています。また、全ての製品でASIL Dを満たしています。4M～62MBまでのメモリーをオプションとして用意し、ダウンタイムなしのOTA(over-the-air)を実現します。

■ 共通ハードウェア/アーキテクチャ・プラットフォーム

様々なオートモーティブ機器とアプリケーションに対応し、ハードウェアとソフトウェア・リユース率を最大化

■ 特長

- ハードウェア・ソフトウェアのリユース率を最大限にソフトウェアの再利用が可能になることで負担の低減に貢献
- 処理性能は10倍となり、機能の追加や拡張に柔軟に対応可能
- ASIL Dに準拠できるよう、4つの独立したハードウェアセキュリティエンジンを用意
- OTAへの対応も実現し、各種アプリケーション向けに様々なファミリーを展開中



■ ターゲット領域

Connectivity	Driver Replacement	Powertrain & Vehicle Dynamics	Body & Comfort
C&S (Connectivity & Security)	ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)	VDS (Vehicle Dynamics & Safety)	GPIS (General Purpose & Integrated Solutions)
ゲートウェイ/ドメインコントローラー向けセキュリティ/OTA対応	レーダー、LIDAR、Vision向け 特にレーダー向けは市場トップ実績	パワトレ、BMS、トランスミッション等のエンジン周辺アプリに加え、汎用モーターコントロール、ブレーキング、ステアリング等の車両運転性向けに特化	ライティングやHVAC等のボディー向けやウィンドウリフトやポンプ、センサーインターフェイス等の汎用モーターコントロールに特化

お問い合わせ先／プロダクトマーケティングユニット NXPグループ nxp@nexty-ele.com



NXP セミコンダクターズ社

i.MX 8M Miniシリーズ ～高性能、低価格なアプリケーションプロセッサ～

i.MX 8M Miniシリーズは民生用機器ならびに産業用機器や制御系の組込み機器に向けた主力プロセッサです。電子看板や監視カメラ、音響機器、FA用制御端末の他、音声制御を付加したスマート家電にも最適です。

i.MX 8M Mini

先進14LPC FinFETプロセス技術を採用した組込みマルチコア・ヘテロジニアス・アプリケーション・プロセッサ i.MX 8M Miniを2018年3月に発表。現在、量産中です。

高性能コンピューティング、高電力効率、組込みセキュリティを組み合わせ、急成長中のエッジ・ノード・コンピューティング、ストリーミング・マルチメディア、機械学習アプリケーションの普及をけん引しています。最大2GHzで動作する最大4個のArm(R) Cortex(R)-A53コアと400+MHzで動作するCortex-M4コア・ベースのリアルタイム・プロセッシング・ドメインが特長です。ハードウェア1080pビデオ・アクセラレーションを統合しており、双方向ビデオ・アプリケーションや2D/3Dグラフィックスを可能にし、豊かなビジュアルHMIの体験を提供します。

■特長

- 最大2GHzのクワッド・コアArm Cortex-A53コア
- 400+MHzで動作するArm Cortex-M4コア
- 1080pビデオ・エンコード/デコード
- 2D/3Dグラフィックス
- ディスプレイ/カメラ・インターフェイス
- マルチチャンネル・オーディオ/デジタル・マイクロフォン入力
- Wi-Fi/BT, Ethernet, USB, メディア・ストレージ向けの広範なコネクティビティ・オプション
- 低消費電力の標準DDRメモリ・サポート
- CPUコアはシングル、デュアル、クアッドから選択可能
(いずれもS/W、PKGに互換性があるため、開発途中のチップの載せ替えが容易)



i.MX 8M Mini



i.MX 8M Mini EVK

PMICについて

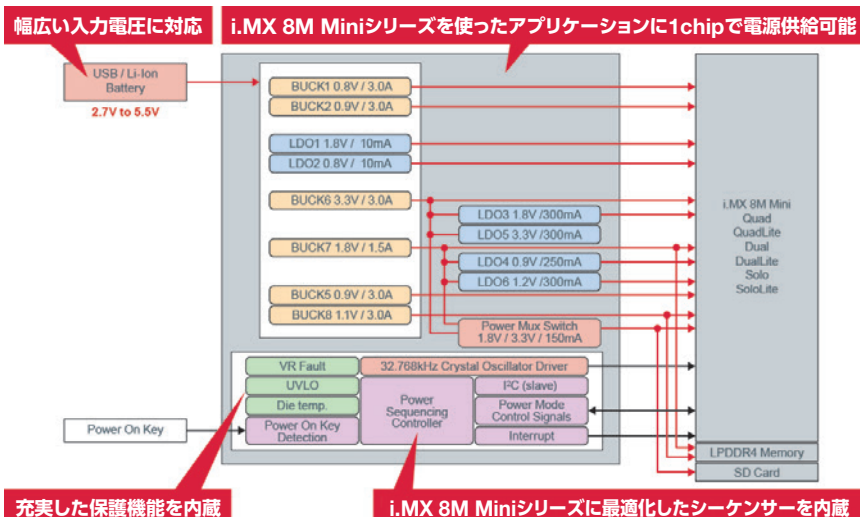
i.MX 8M Miniのパワー・マネジメントIC (PMIC) は、NXPが提供するEVKに搭載されているローム社のBD71847AMWVがお奨めです。

BD71847AMWVは、i.MX 8M Miniシリーズに必要な電源や保護機能を1チップで供給すると同時に、最適な電源管理を行うon/offシーケンサーも内蔵しているため、小型化の実現が可能であり、かつアプリケーション設計を容易にすることができるため、開発期間の大幅な削減に貢献します。

■BD71847AMWVの特長

- 入力電圧2.7V~5.5V
- 降圧DC/DCコンバーター (Buck Converter)×6ch, LDO×6ch
- SDカード駆動用パワーマルチプレクサ搭載
- 32.768kHz水晶発振回路内蔵
- 多彩な保護機能搭載
(ソフトスタート機能、パワー・レールエラー検出、過電圧保護、過電流保護など)
- I2Cインターフェイス対応 (Max 1MHz)
- 割り込み機能 (マスク機能付き)

■i.MX 8M Miniシリーズの各パワー・レールに最適化



お問い合わせ先／プロダクトマーケティングユニット NXPグループ nxp@nexty-ele.com

NXP セミコンダクターズ社

LPCシリーズ・Kinetisシリーズ・i.MX RTマイコン ～幅広いラインナップのArmコアマイコン～

NXPは幅広い性能と周辺機能をもったArmコアマイコンを提供します。

Cortex-M0, M0+, M3, M4F, M33, M7を搭載し、各々に特長を持たせて提供することで、お客様のニーズに対し、様々な角度から幅広いシステムソリューションの構築が可能です。

高性能・豊富な機能を持ったシステム構築なら、i.MX RTがおすすめ

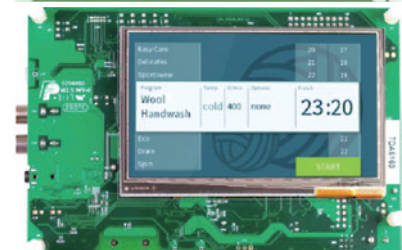
i.MX RTクロスオーバー・プロセッサ・シリーズは高い性能とリアルタイム動作の組み合わせにより、高度な統合やセキュリティ機能とMCUレベルの使いやすさを適切な価格で両立させており、次世代IoTアプリケーションをサポートします。

■ 特長

- Cortex-M7コア、3015 CoreMark/1284 DMIPS@600MHz
- 2Dグラフィック・アクセラレーション・エンジン
- パラレル・カメラ・センサ・インターフェイス
- LCDディスプレイ・コントローラ（最大WXGA 1366x768）
- 高性能マルチチャンネル・オーディオ向けI2S
- NAND、eMMC、QuadSPI NOR Flash、Parallel NOR Flash
- 低コスト、単一電源、4層基板実装

■ ターゲット・アプリケーション

- オーディオサブシステム
- スマート家電、カメラ、LCD
- ホーム/ビルディング・オートメーション
- 産業用コンピューティング
- モーター制御/電力変換



i.MX RT



K32 Lシリーズ

超低消費電力とセキュリティのCortex-M4コアマイコンK32シリーズ

リアルタイム組込みアプリケーションのエネルギー効率向上と、物理的改ざん保護によるセキュリティ強化を実現するK32シリーズを2019年3月に発表しました。

- *動作電圧範囲の広い低デューティ・サイクル・アプリケーションに最適な電力効率の高い、フルSRAMリテンションと高速ウェイクアップをサポートする超低リーク電力モード
- *アーキテクチャを向上し消費電力を最適化した専用ハイパフォーマンス・ミックスドシグナル(HPMS)
- *デバイス認証、機密性、物理的改ざん検知/耐性のための先進組込みセキュリティ機能

■ 特長

オプションのCortex-M0+コアを備えた72MHz Arm(R) Cortex(R)-M4ベースMCUです。K32 L3ファミリは最大1.25MBのフラッシュ、384KBのSRAMのほか、多数のシリアル通信インターフェイス、12ビット1MSPS ADC、10ビットDAC/コンパレータ、32ビットPWMタイマ・モジュール、拡張のフレキシビリティを高める外付けメモリ・コントローラを備えています。K32 L3シリーズは全体で512KBから1.28MBのフラッシュ・サイズをサポートします。



ネクスティ エレクトロニクスでは各種開発環境・OS/ドライバーなどのサードパーティー製品をご紹介・ご提供しています。
また、ARM開発環境の導入支援・トレーニングについてもお問い合わせください。

お問い合わせ先／プロダクトマーケティングユニット NXPグループ nxp@nextty-ele.com



NXP セミコンダクターズ社

NFC準拠NTAG12C Plus (NT3H21xx) 及び各種RFIDタグIC

スマートフォンを中心に普及が加速しているNFCを中心にNXPでは製品ラインナップを取り揃えています。お客様の設計したアプリケーションに対し、簡単にNFC機能やRFID機能を追加可能なNFC/RFIDタグICをご紹介します。

NFCとは

NFCとは、至近距離でデータ通信を行う近距離無線通信の国際標準の一つ。2002年にISO/IEC 18092として勧告された方式で、ソニーの「FeliCa」とNXPセミコンダクターズの「Mifare」をもとに策定された通信規格であり、機器同士を「かざす」ように近づけ10cm程度のごく近距離で、100～400kbpsの双方向通信ができます。ICカードの場合には電池や電源が不要で、アンテナが電波を受信する際の電磁誘導で発生した電力だけで、通信やデータの書き換えができるという特長があります。カード型電子マネーなどの非接触ICカードや、携帯電話、スマートフォンなどで使われています。

■ NFCの特長

- CBLE/Wifiとのペアリングが20倍早い
- 即座にデバイスを認識
- アクセサリの誤接続を防止

■ NFCのターゲット製品

- 企業/大学/イベント会場などのアクセスコントロール
- 自宅/ホテルなどのスマートロックシステム
- コントロール制御のある特殊機械
- プリンタのように複数ユーザーが使う機械

■ NFC対応NXP製品

- NFC R/W IC
- ISO15693・ISO14443マルチプロトコル対応R/W IC
- NFC TAG / NTAG I2C (I2Cポート付きNFCタグ)
- そのほかHF帯、UHF帯TAG IC各種

■ 採用実例



Bluetoothデバイスとの接続を手早くかつスムーズに



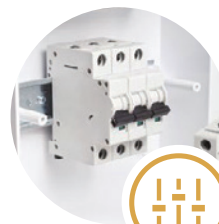
プライベートなコンサートホールを作り出して音源を共有



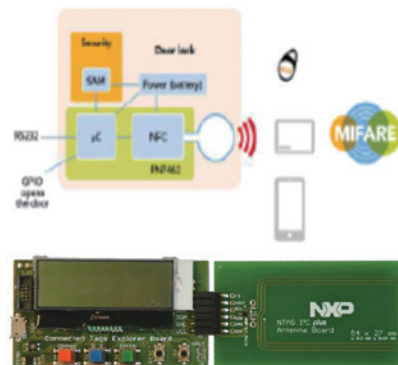
認証されたリダイレクトにより、純正の交換品・消耗品をワンタッチで注文



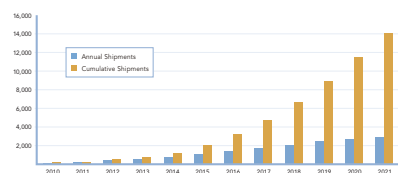
付属品や装備品の認証化により、偽造品を防止



完全密閉式でバッテリーのないセンサー・ユニットと、メーター・ハウジングの通信



NFC搭載製品 (年間出荷数、累積出荷数)



出典：NXP資料より

※MifareはNXPセミコンダクター社の登録商標です。
 ※IcodeSLIはNXPセミコンダクター社の登録商標です。
 ※FeliCaはソニー社の登録商標です



ネクスティ エレクトロニクスではお客様のご要望に沿ってカスタム開発、ソフトウェア受託開発、ソリューション提案をいたします。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先／プロダクトマーケティングユニット NXPグループ nxp@nexty-ele.com



NXP セミコンダクターズ社 RFIDモジュール

「RFIDを簡単に組み込みたい」「少ロットでリーダーライター開発は難しい」「様々な認証を取ることが面倒」といった悩みをモジュールで解決します。当社で紹介する株式会社アートファイネックス製R/WモジュールはUHF帯、HF帯の製品を取り揃えており昨今のRFID組み込みニーズを簡単に実装することができます。

会社概要

会 社 名：株式会社アートファイネックス

本社所在地：福井県鯖江市/東京支社：千代田区内神田

事 業 内 容：RFID製品の開発・販売およびコンピュータシステムの開発並びに輸送機器事業

URL : <https://artfinex.co.jp/>

■取り扱い製品

- HF帯 (13.56MHz) マルチモード(ISO15693、ISO14443A/B、ISO18092)対応R/W
- 即HF帯NFC対応R/W
- UHF帯 (920MHz) R/W、各種アンテナ製品
 - 免許申請不要の特定小電力モデルから長距離通信に適したハイレンドモデルを用意
- 各種RFIDタグ・ダイナミックタグ

■特長

- RFID用R/W各種ソリューションを高品質
日本設計・生産にてお届け
- HF帯、UHF帯の両ソリューション展開
- お客様の用途に合わせてR/W・タグを提案

■採用事例

個品・機密管理

重要品や劇薬品といった数が多く探しづらい物の所在管理や、利用者のICカードに用いた事例



個品・機密管理

製造現場や倉庫などで動くもの(現品や伝票など)にRFIDタグを用いた事例



入退場管理

人や車両の入場・退場、資格の有無をICカードやRFIDタグを用いて認証した事例



医療・介護向け

医療機器にRFIDを採用し、稼働時間管理・所在管理、介護者の監視・緊急通報用途向け事例



HF 帯製品



UHF 帯製品



■RFID方式一覧表

項 目	方 式	電磁誘導方式		電波方式	
		長波帯	短波帯	UHF帯	マイクロ波帯
中心周波数		120~135KHz	13.56MHz	860~960MHz	2.45GHz
交 信 距 離		~数10cm	~70cm	~数m	~1.5m
アンチコリジョン		可能	可能	可能	可能
指 向 性		広	中	中	狭
通 信 速 度		遅い ← → 速い			
金属による影響		基本的に影響を受ける 事前検証が必要			
水分からの影響		少ない		中	大
特 長		指向性が広い使用環境に左右されにくい	最も普及している媒体・機種が豊富使用環境に左右されにくい	通信速度が速い使用環境に左右されやすい 2012年7月の電波法改正	小型化が容易 指向性が強い



ネクスティ エレクトロニクスではRFIDの規格、方式、各国対応の相談を承っております。
各種カスタム、導入支援をしていますので、お問い合わせ下さい。「つながるを簡単に」をテーマとして各種デモをそろえています。

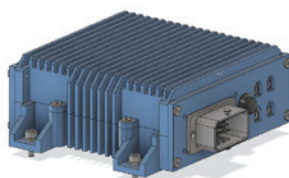
お問い合わせ先／プロダクトマーケティングユニット NXPグループ nxp@nexty-ele.com

NVIDIA社 自動運転システムソリューション & Jetson新製品紹介

NVIDIA社ではAIコンピューティングカンパニーとして、エッジ側でのAI推論に必要な高い処理能力と低消費電力を兼ね備えた自律動作マシン向けSOM (System-on-Module) 『Jetson™』の開発に力を入れております。今回はそのJetson製品をベースとした当社独自の量産向けソリューションとJetsonの新製品について紹介します。

■ 農機建機向け自動運転システムソリューション

自動運転システムを全てのモビリティ分野へ展開することを目指し、当社ではNVIDIA社のJetson TX2i™をベースとした自動運転システム向けリファレンスECUを開発致しました。これにより、Jetsonモジュールをより堅牢なECUとして機器に搭載することが可能です。またこのECUをベースとして、お客様の要件に合わせたカスタマイズにより、独自ECU開発のご提案します。



■ 特長

- ・ヒートシンクを用いた自然冷却
- ・堅牢な筐体によるハードウェア耐性：耐湿及び耐水/振動・衝撃耐性/温度特性拡張
- ・高い電気特性：EMS、逆接続、過渡電圧 耐性
- ・集合コネクタによる車体側とのインターフェイスが可能
- ・4つの車載向けGMSLカメラを搭載

インターフェイス	詳細
USB	2 x USB 3.0 Port (HS/SS) / 1 x USB 2.0 Port/ Flash用USB Port
Networking	2 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) RJ-45s
CAN	2 x CAN Ports (J1939)
Display	1 x HDMI 2.0
Camera Input	4 x GMSL Camera
Input Power	1 x 12[V] / 24 [V] DC Input
ECU内部インターフェイス	1 x UART Port (RS232 Levels) / 4-bits of 3.3V GPIO

■ NVIDIA Jetson NANO Development Kit

Jetson Nano Developer Kitはサイズ/消費電力/コストのバランスの優れたAIワークロード向けのコンピューティングパフォーマンスを提供します。これを使用する開発者、エンジニアはイメージクラシフィケーション、オブジェクトディテクション、セグメンテーション、音声処理向けなどあらゆるAIフレームワークやモデルを手にすることが出来ます。

またNVIDIA(R) Jetson™ Nano™ Development Kitはmicro-USB給電が可能で、CSIからGPIOの拡張I/Oを備え、様々なセンサー接続に対応したAIアプリケーション開発をわずか5Wという低消費電力で実現します。

DEVELOPER KIT

GPU	128-core Maxwell
CPU	Quad-core ARM A57 @ 1.43GHz
Memory	4GB 64-bit LPDDR4 25.6GB/s
Storage	microSD (not included)
Video Encoder	4K @ 30 4x 1080p @ 30 9x 720p @ 30 (H.264/H.265)
Video Decoder	4K @ 60 2x 4K @ 30 8x 1080p @ 30 18x 720p @ 30 (H.264/H.265)
Camera	1x MIP CSI-2 DPHY lanes
Connectivity	Gigabit Ethernet, M.2 Key E
Display	HDMI 2.0 and eDP 1.4
USB	4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B
Others	GPIO, I ² C, I ² S, SPI, UART
Mechanical	100mm×80mm×29mm

*Please refer to NVIDIA documentation for what is currently supported



お問い合わせ先／マーケティング第3部 NVIDIAグループ nvidia-info@nexty-ele.com

最新! CoolMOS P7シリーズのご紹介 ~各耐圧ラインナップが揃いました~

スーパージャンクション型MOSFETの老舗、インフィニオン テクノロジーズ社より最新シリーズCoolMOS P7のご紹介です。CoolMOS P7は従来の使いやすさ、高性能、高効率に加え、コストパフォーマンスを併せ持った最強シリーズです。各耐圧のラインナップが揃いましたので、あらゆるアプリケーションに提案可能、この機会にぜひご検討ください。サンプル、お見積りのご依頼はネクスティ アドバンスト テクノロジーまで!

概要

- ・スーパージャンクション型MOSFET
- ・最新(第7)世代プロセス
- ・20年以上の実績

特長

- ・耐圧600~950V幅広いラインナップ
- ・産業用・民生用グレードを用意(600V)
- ・面実装、スルーホール各種パッケージを用意
- ・各アプリケーション全方位的に対応

アプリケーション

- ・産業用電源
- ・LED照明
- ・コンシューマー製品
- ・ACアダプター



新製品

■600V

産業用グレード									
$R_{DS(on)}$ (mΩ) Max.	PAK	D ² PAK	ThinPAK 8×8	TO-220 FullPAK	TO-220	TO-220 FullPAK Wide Creepage	TO-247	TO-247 4pin	SOT-223
600	IPD60R600P7			IPA60R600P7	IPP60R600P7				
360/365	IPD60R360P7	IPB60R360P7	IPL60R365P7	IPA60R360P7	IPP60R360P7				
280/285	IPD60R280P7	IPB60R280P7	IPL60R285P7	IPA60R280P7	IPP60R280P7				
180/185	IPD60R180P7	IPB60R180P7	IPL60R185P7	IPA60R180P7	IPP60R180P7		IPW60R180P7	IPZ60R180P7	
120/125		IPB60R120P7	IPL60R125P7	IPA60R120P7	IPP60R120P7		IPW60R120P7	IPZ60R120P7	
99/104		IPB60R099P7	IPL60R104P7	IPA60R099P7	IPP60R099P7		IPW60R099P7	IPZ60R099P7	
80		IPB60R080P7	IPL60R085P7	IPA60R080P7	IPP60R080P7		IPW60R080P7	IPZ60R080P7	
60/65		IPB60R060P7	IPL60R065P7	IPA60R060P7	IPP60R060P7		IPW60R060P7	IPZ60R060P7	
37							IPW60R037P7	IPZ60R037P7	
民生用グレード									
600	IPD60R600P7S			IPA60R600P7S		IPAW60R600P7S			IPN60R600P7S
360/365	IPD60R360P7S			IPA60R360P7S		IPAW60R360P7S			IPN60R360P7S
280/285	IPD60R280P7S			IPA60R280P7S		IPAW60R280P7S			
180/185	IPD60R180P7S			IPA60R180P7S		IPAW60R180P7S			

■700V

$R_{DS(on)}$ (mΩ)	TO-220 FullPAK	TO-220 FullPAK Narrow Lead	TO-252 DPAK	TO-251 IPAKショートリード	TO-251 IPAKショートリード ISOスタンダード付き	SOT-223	ESDクラス	
							CDM	HBM
2000					IPSA70R2K0P7S	IPN70R2K0P7S	Class C3 ≥1kV	Class 1C 1-2kV
1400			IPD70R1K4P7S	IPS70R1K4P7S	IPSA70R1K4P7S	IPN70R1K4P7S		
1200					IPSA70R1K2P7S	IPN70R1K2P7S		
900	IPA70R900P7S	IPAN70R900P7S	IPD70R900P7S	IPS70R900P7S	IPSA70R900P7S	IPN70R900P7S		
750	IPA70R750P7S	IPAN70R750P7S			IPSA70R750P7S	IPN70R750P7S		
600	IPA70R600P7S	IPAN70R600P7S	IPD70R600P7S	IPS70R600P7S	IPSA70R600P7S	IPN70R600P7S		
450	IPA70R450P7S	IPAN70R450P7S			IPSA70R450P7S	IPN70R450P7S	Class 2 (2kV-4kV)	Class 2 2-4kV
360	IPA70R360P7S	IPAN70R360P7S	IPD70R360P7S	IPS70R360P7S	IPSA70R360P7S	IPN70R360P7S		

■800V

R _{DS(on)} (mΩ)	TO-220 FullPAK	TO-220 FullPAK Narrow Lead	TO-252 DPAK	TO-220	TO-247	TO-251 IPAK	TO-251 IPAK SL	SOT-223	ESDクラス		
									HBM	CDM	
4500			IPD80R4K5P7			IPU80R4K5P7		IPN80R4K5P7	Class 1C (1kV-2kV)	Class C3 (≥1kV)	
3300			IPD80R3K3P7			IPU80R3K3P7		IPN80R3K3P7			
2400			IPD80R2K4P7			IPU80R2K4P7	IPS80R2K4P7	IPN80R2K4P7			
2000			IPD80R2K0P7			IPU80R2K0P7	IPS80R2K0P7	IPN80R2K0P7			
1400	IPA80R1K4P7		IPD80R1K4P7	IPP80R1K4P7		IPU80R1K4P7	IPS80R1K4P7	IPN80R1K4P7	Class 2 (2kV-4kV)		
1200	IPA80R1K2P7		IPD80R1K2P7	IPP80R1K2P7		IPU80R1K2P7	IPS80R1K2P7	IPN80R1K2P7			
900	IPA80R900P7		IPD80R900P7	IPP80R900P7		IPU80R900P7	IPS80R900P7	IPN80R900P7			
750	IPA80R750P7		IPD80R750P7	IPP80R750P7		IPU80R750P7	IPS80R750P7	IPN80R750P7			
600	IPA80R600P7		IPD80R600P7	IPP80R600P7		IPU80R600P7	IPS80R600P7	IPN80R600P7			
450	IPA80R450P7	IPAN80R450P7	IPD80R450P7	IPP80R450P7							
360	IPA80R360P7	IPAN80R360P7	IPD80R360P7	IPP80R360P7	IPW80R360P7						
280	IPA80R280P7	IPAN80R280P7	IPD80R280P7	IPP80R280P7	IPW80R280P7						

■950V

R _{DS(on)} (mΩ)	TO-220FP	IPAK LL	DPAK	SOT-223	ESDクラス	
					HBM	CDM
3700		IPU95R3K7P7		IPN95R3K7P7	1C(>1kV)	Class C3(>1kV)
2000		IPU95R2K0P7	IPD95R2K0P7	IPN95R2K0P7	2(>2kV)	
1200	IPA95R1K2P7	IPU95R1K2P7	IPD95R1K2P7	IPN95R1K2P7		
750	IPA95R750P7	IPU95R750P7	IPD95R750P7			
450	IPA95R450P7	IPU95R450P7	IPD95R450P7			

お問い合わせ先/NEXTY Advanced Technology Company (インフィニオン製品取扱いカンパニーグループ) 営業1部 ICTグループ URL:<http://www.nexty-ele.com/nat/>

Maestro Wireless Solutions社 IoT/M2Mのゲートウェイとして最適な通信端末のご紹介

Maestro Wireless Solutions Ltd.は香港に本社をおく、Maestro & FALCOM Holdings Limited配下のIoT/M2M 端末メーカーです。グループのFALCOM社はGPSトラッカー、テレマテックスサービスを提供しており、Maestro及びFALCOMの2社でIoT/M2M端末からサービスまで提供いたします。

Maestro & FALCOM Holdings Limited

本 社	香港
業 種	IoT/M2M 端末製造・販売、サービスプロバイダー
社 歴	25年
出 荷 実 績	150万台超 (2015年度ワールドワイド第3位)※
開 発 拠 点	インド、ドイツ、中国
製 造 拠 点	中国、ドイツ
販 売 拠 点	EU、北米、インド、香港

※マエストロ社調べ

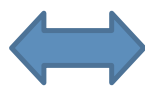
maestro
empowering wireless
モデム、ルーター、ゲートウェイ

FALCOM
GPSトラッカー、テレマテックス

特長

お客様のアプリケーションに適した以下を提供します。

- 1) インターフェイス (RS232C、RS485、Modbus RTU/TCP、LAN、W-LAN、1-wire、BLE、CAN)
- 2) 端末 (モデム、ルーター、GPSトラッカー、テレマテックス)
- 3) ネットワーク接続 (有線、LTE Cat.4、Cat.1、M1、NB-IoT)
- 4) グローバルSIM、デバイス管理サーバ
- 5) 大手プロバイダーIoTプラットフォームへの接続環境



RS232C
RS485
LAN
W-LAN
USB



E220



E210



M110



BOLERO

GNSS



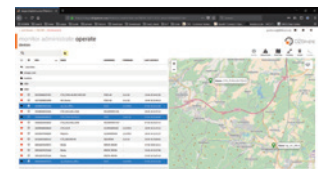
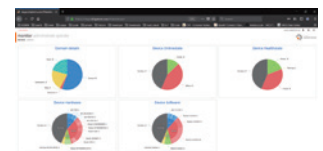
D2Share server

LTE



Cloud server

D2SPHERE™
デバイス管理ソフト



D2Sphere機能

- 1) デバイス管理
- 2) デバイス稼働監視
- 3) ソフト、設定の変更

IoT/M2M 端末-ラインナップ

製品名	M1003GXT04	M114#1J	FOX3-3G
外 形			
基本機能	Small size 2G/3G Modem GPS	Small size LTE Cat. 1	2G/3G ゲートウェイ 車輻運送管理、GPSトラッカー
周波数	・GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz ・WCDMA/HSDPA: 900/2100MHz	LTE Band 1, 19	・GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz ・WCDMA/HSDPA: 800/850/900/1900/2100MHz
通信速度	UP:384kbps DN:3.6Mbps	UP: 5Mbps DN:10Mbps	U: 5.76Mbps DN:7.2Mbps
インターフェイス	USB2.0/RS232C	RS232C USB	I/O(Ignition, Analog, digital in/out), RS232C, RS485, CAN, 1-wire, I2C, USB
動作温度	-40°C~+85°C	-40°C~+85°C	-40°C~+85°C
認 証	日本	日本	日本、CE
その他	欧州、北米、アジア向けモデル有	LTE M1、NB-IoTモデル有	LTEモデル、BLE、Liteモデル有

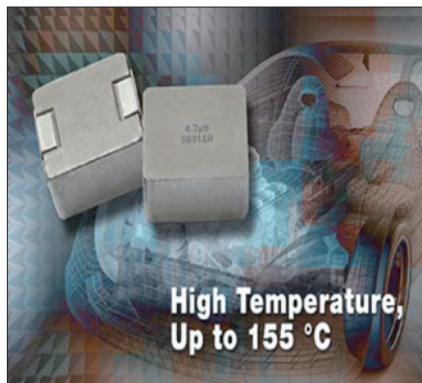
製品名	BORERO-45	E218#1JL	E228#1JL
外 形			
基本機能	GPSトラッカー 2G/3G IP68, Dual SIM	M2M LTE Gateway OS: Linux Middle ware: TCP/IP, PPP DUAL SIM	M2M LTE Gateway OS: Linux Middle ware: TCP/IP, PPP GPS
周波数	・ GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz ・ WCDMA/HSDPA: 800/850/900/1900/2100MHz	LTE Band 1, 19, 21	LTE Band 1, 19, 21
通信速度	U: 5.76Mbps DN: 7.2Mbps	UP: 50Mbps DN: 150Mbps	UP: 50Mbps DN: 150Mbps
インターフェイス	RS232C (RX, TX) GPIO x 2 イグニッション入力	LAN, WAN, RS232C 2 x mini SIM, eSIM, micro SSD card	GNSS LAN, WAN, RS485C, WiFi Mini SIM, eSIM
動作温度	-40°C~+85°C	-20°C~+60°C	-30°C~+70°C
認 証	日本、CE	日本	日本
その他	CAN、M1、NB-IoTモデル有	2G/3G、EU、北米、アジア向け有 LTE M1、NB-IoTモデル有	2G/3G、EU、北米、アジア向け有

お問い合わせ先／営業12部 <http://www.nexty-ele.com>

VISHAY 社 車載向け IHLP 5050/6767 サイズの新製品発表

半導体、電子部品の総合メーカーであるVISHAY社より今回ご紹介するのは、AEC-Q200準拠、車載グレードの新製品2つです。各製品ともにそれぞれ薄型/低背パッケージかつ高温動作の特長をもっており、エンジンルーム周辺での省スペースアプリケーションに最適です。

■ 車載グレード IHLP® インダクタ (IHLP-5050EZ-5A, IHLP 6767GZ 8A)



■ 車載グレードの薄型大電流の新製品で、高温動作と薄さ/低背が特長

① IHLP-5050EZ-5A

- 車載グレードの薄型大電流IHLP5050 (13.3mm×12.9mm) ケースサイズの新製品で、+155°Cまでの高温動作と5mmの薄さが特長で、エンジン周りの用途で省スペース化を提供します。

② IHLP 6767GZ 8A

- 車載グレードの薄型大電流IHLP6767 (17mm×17mm) ケースサイズの新製品で、+180°Cまでの連続高温動作と7mmの低背を特長とし、エンジンルームでの省スペースアプリケーションに最適です。

■ 幅広いインダクタンス値を提供、高効率を実現。

① IHLP-5050EZ-5A

- 0.69mΩ～188.0mΩの標準DCR、0.22μH～82.0μHの幅広いインダクタンス値を提供、高効率を実現します。定格電流は69.24Aまで飽和せずに高レベルの過渡電流スパイクを扱えます。

② IHLP 6767GZ 8A

- 0.89mΩ～52.7mΩの標準DCR、0.47μH～47.0μHの幅広いインダクタンス値を提供、高効率を実現します。定格電流は76.0Aまで飽和せずに高レベルの過渡電流スパイクを扱えます。

■ 補足

- 2MHzまでのDC/DCコンバーターのエネルギー貯蔵インダクタとして最適です。
- 大電流フィルタアプリケーション向けのインダクタとしては自己共振周波数まで使用可能で、十分なノイズ減衰を提供します。
- 100%鉛フリーでシールドされたコンポジット構造のパッケージによりバズノイズのレベルは極めて低く、熱衝撃、湿度、機械的衝撃に強いです。
- RoHSに準拠、ハロゲンフリーでVISHAY社の「グリーン標準」に適合しております。

■ アプリケーション

- 高温動作が特長のデバイスは、エンジン、トランスミッション制御装置、ディーゼル燃料噴射システム、その他エンジンルームでの各種アプリケーション用フィルタリングやDC/DC変換、モーターやワイパー、パワーミラーや電動シートからのノイズ抑制、HID/LED照明、暖房と換気送風装置などに最適です。

■ 主なデバイス仕様 (IHLP-5050EZ-5A, IHLP 6767GZ 8A)

■ IHLP-5050EZ-5A

Case size	5050
Profile (mm)	5.0
Inductance range (μH)	0.22～82.0
DCR typ. (mΩ)	0.69～188.0
DCR max. (mΩ)	0.76～201.0
Heat rating current (A)	3.0～68.18
Saturation current (A)	3.10～69.24
SRF typ. (MHz)	2.9～99.9

■ IHLP 6767GZ 8A

Case size	6767
Profile (mm)	7.0
Inductance range (μH)	0.47～47.0
DCR typ. (mΩ)	0.89～52.7
DCR max. (mΩ)	0.95～56.4
Heat rating current (A)	7.25～65.0
Saturation current (A)	7.0～76.0
SRF typ. (MHz)	3.72～52.3

お問い合わせ先／マーケティング第3部 Vishayグループ vishay-pm-sales@nexty-ele.com

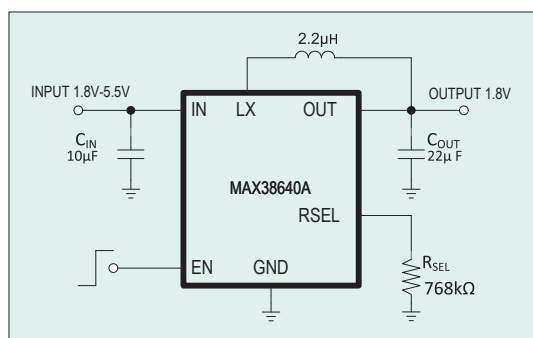
Maxim Integrated社 nanoPowerバックコンバーターMAX38640の紹介

MAX3864xA/Bは、nanoPowerファミリの超低330nA自己消費電流バック(ステップダウン) DC-DCコンバータで、1.8V～5.5Vの入力電圧で動作し、96%のピーク効率で最大175mA、350mA、700mAの負荷電流に対応します。シャットダウン時、シャットダウン電流はわずか5nAです。これらのデバイスは、超低自己消費電流、小型総ソリューションサイズ、および全負荷範囲に渡る高効率を提供します。MAX3864xA/Bは、長いバッテリー寿命が必須のバッテリーアプリケーションに最適です。

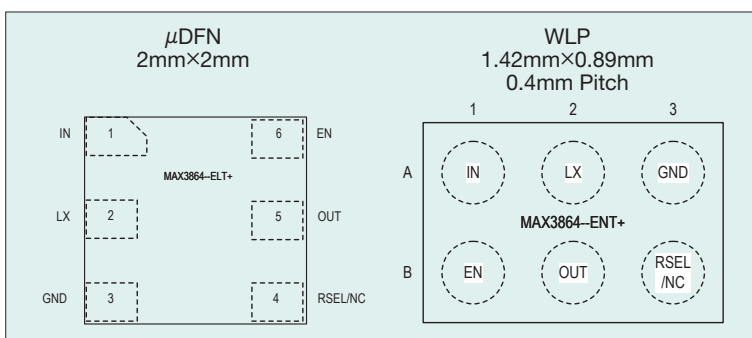
主な特長

- バッテリー寿命を延長
 - 超低自己消費電流：330nA
 - シャットダウン電流：5nA
 - ピーク効率：96% (10μAで88%以上)
- 使用が容易、一般的な動作に対応
 - 入力範囲：1.8V～5.5V
 - 設定済みVOUT：0.5V～5V
 - 1つの抵抗で設定可能なVOUT：0.7V～3.3V
 - 出力電圧精度：±1.75%
 - 負荷電流：最大175mA/350mA/700mA
- 複数の使用法でシステムを保護
 - シャットダウン時の逆方向電流ブロック機能
 - オプションのアクティブ放電機能
- サイズを小型化し信頼性を向上
 - 温度範囲：-40℃～+85℃

回路構成



パッケージ



豊富なラインナップ

PART NUMBER	PEAK INDUCTOR CURRENT (A)	ACTIVE DISCHARGE	FEATURES	PACKAGE	
MAX38640AELT+	0.25	Yes	0.7V to 3.3V Resistor-Selectable Output Voltage Using RSEL (Resistor Select) Pin	6-pin 2mm×2mm μDFN	
MAX38641AELT+	0.50	Yes			
MAX38642AELT+	0.50	—			
MAX38643AELT+	1.00	Yes			
MAX38640BELT+	0.25	Yes	0.5V to 5V Preprogrammed Output Voltage		
MAX38641BELT+	0.50	Yes			
MAX38642BELT+	0.50	—			
MAX38643BELT+	1.00	Yes			
MAX38640AENT+	0.25	Yes	0.7V to 3.3V Resistor-Selectable Output Voltage Using RSEL (Resistor Select) Pin	6-pin 2mm×3 0.4mm Pitch WLP	
MAX38641AENT+	0.50	Yes			
MAX38642AENT+	0.50	—			
MAX38643AENT+	1.00	Yes			
MAX38640BENT+	0.25	Yes	0.5V to 5V Preprogrammed Output Voltage		
MAX38641BENT+	0.50	Yes			
MAX38642BENT+	0.50	—			
MAX38643BENT+	1.00	Yes			

お問い合わせ先／マーケティング第3部 Maximグループ maximg_members@nexty-ele.com

ネクスティ エレクトロニクスの取組紹介

2019年4月16日プレスリリース

自動運転基本ソフトウェアAutowareと連携可能なMATLAB®/Simulink®サンプルを公開 ～GitHub上でオープンソースとして公開し自動運転開発を促進～

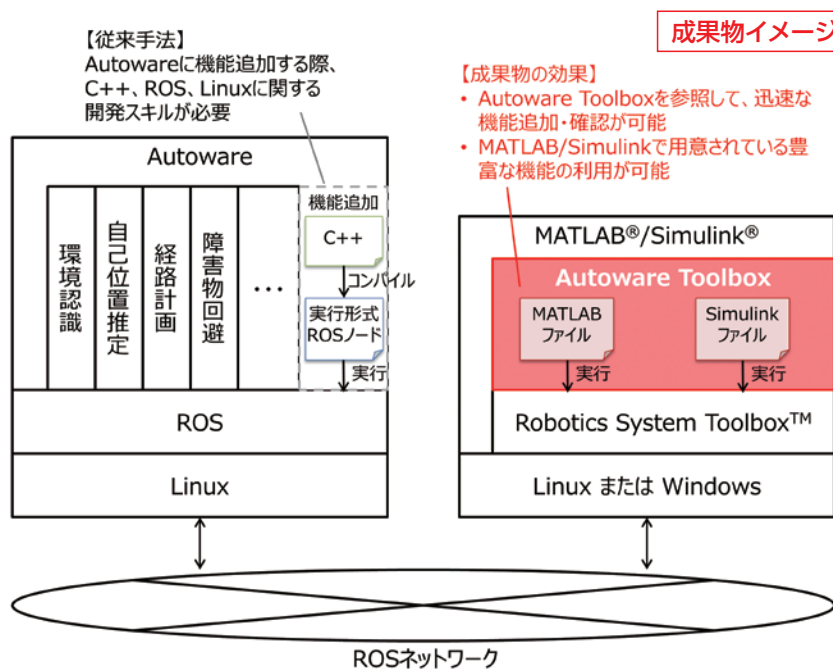
ネクスティ エレクトロニクスは自動運転基本ソフトウェアAutowareと連携できるモデルベース開発ツールMATLAB/SimulinkのRobot Operating System (以下、ROS) ノードの開発を埼玉大学 (安積研究室) と共同で開始し、ソフトウェア開発プラットフォームのGitHub^{*1}でオープンソースソフトウェアとして2019年4月16日に公開^{*2}しました。

※1 GitHub : <https://github.com/>

※2 公開リポジトリ : https://github.com/CPFL/Autoware_Toolbox

ポイント

- 自動運転用のソフトウェアAutowareと接続可能なMATLAB/Simulink のROSノードのサンプルを開発し、オープンソースとして公開した。
- これにより、自動運転システムに搭載されるソフトウェア開発において、Linux環境やC++言語に不慣れな開発者の工数削減が可能になるとともに、ソフトウェア開発の試作と評価の素早い反復が可能となり、自動運転システムに搭載されるソフトウェアの複雑化、大規模化に伴い、課題となっている開発コスト・時間の削減が期待される。
- オープンソースとして公開することで、企業や大学などとの連携が容易になり、様々な技術やアイデアを結合させることが可能。自動運転システム開発におけるエコシステムを形成し、新たなサービスや製品開発につなげていくことが期待される。



関連書籍のご紹介

当社にて、関連書籍を発行しております。ぜひこちらもお読みください。

- 急にMATLAB/Simulinkを使うことになった時に読む本



2018年3月

- CコードからのSimulinkモデルの作成



2018年8月

URL



URL



お問い合わせ先／組込みソリューション本部 <http://www.nexty-ele.com>

2019年5月8日プレスリリース

株式会社 ネクスティ エレクトロニクスとモデルベース開発ツールベンダーのETASが業務提携

ネクスティ エレクトロニクスとECUソフトウェアの開発工程全般に対応するソリューションを提供しているイータス株式会社(本社：横浜市西区、代表取締役：横山崇幸、以下「ETAS」)は業務提携をしました。

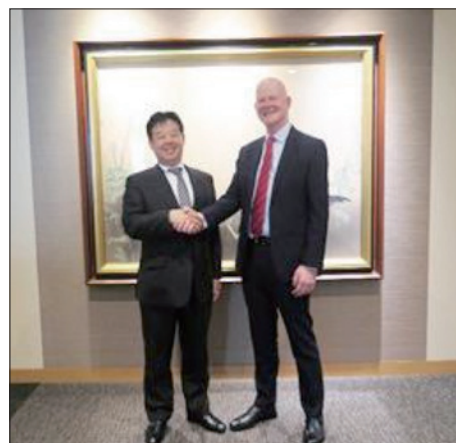
■市場背景及び業務締結の目的

昨今、自動車業界の巨大トレンドであるCASEのうち、自動運転やコネクテッド領域においては、自動車の高度化とともにソフトウェア開発が複雑化、大規模化しています。また、先進運転支援システム(ADAS)/自動運転(AD)領域においてはAIの活用に向けた新技術開発も加速しています。一方、開発現場では開発期間の短縮と品質の確保が求められています。その状況を解決する鍵となるのが、ソフトウェア開発技術力と強力な開発環境を生かした、多様なお客様ニーズに応えることができる迅速なトータルソリューション提案力です。

ネクスティ エレクトロニクスは、先端技術が求められる開発から量産・検証までのお客様の多種多様なニーズに即した提案ができます。また、ETASはソフトウェア開発作業の効率化や自動車全体の開発効率化を解決するモデルベース開発ツール群やエンジニアリングサービス、コンサルティングを多面的に網羅しています。この、両者の強みを活かしお客様へのサポート体制を強化し、シミュレーション開発の領域において、お客様への提供サービス拡大・価値向上を推進し、エンジニアリングサービスを一層強化していきます。



イータス株式会社の詳細についてはこちら⇒URL: <https://www.etas.com>



写真正面左から
(左) 株式会社 ネクスティ エレクトロニクス 代表取締役社長 青木 厚
(右) ETAS GmbH Vice President Sales Christopher White

2019年5月16日プレスリリース

ネクスティ エレクトロニクスとBlackBerry QNXのVAIパートナー契約を締結 ～セキュアでセーフティクリティカルな組み込みソリューションの開発で提携～

ネクスティ エレクトロニクスは5月16日、BlackBerry Limited(本社：カナダオンタリオ州、CEO: ジョン・チェン、NYSE: BB、TSX: BB、以下BlackBerry)と日本国内におけるBlackBerry QNXのDistributor and Value-Added Integrator(以下VAI)プログラムを締結しました。これにより、ネクスティ エレクトロニクスはBlackBerry QNXのDistributor and VAIプログラムに参加し、BlackBerry QNXおよびCerticomテクノロジーの専門家からトレーニングを受け、今後お客様に対し、技術サポートを提供できるようになります。

■背景及び契約締結の目的

自動車業界において、CASEの各分野で技術進化は著しく、迅速な対応が求められている中、ソフトウェアの複雑化や開発規模が増大している。それに伴い、開発現場における開発コストと時間が増大しており、品質の確保をしつつ、これらを削減することが求められています。その状況の中で、カーエレクトロニクス分野においてはトップクラスであるネクスティ エレクトロニクスは、本契約締結を通じ、BlackBerryのQNXの技術的な専門知識を習得し、信頼性の高いBlackBerry QNXの技術サポートを提供することで、市場投入までの期間を短縮していきます。また当社の技術力を強化し、一層モビリティ・システムの拡大、普及に貢献していきます。

■BlackBerry Limitedについて

BlackBerryは、カナダ・オンタリオ州ウォーターlooに本社を置くセキュリティソフトウェア・サービス会社で、企業や政府機関向けに、IoTのセキュリティ保護に必要なテクノロジーを提供しています。安全性、サイバーセキュリティ、およびデータプライバシーに妥協することなく取り組んでおり、人工知能やエンドポイント・セキュリティと管理、暗号化技術、組み込みシステムなどの主要分野をリードしています。

BlackBerry Limitedの詳細についてはこちら⇒URL: <http://www.blackberry.com/ca/en>

お問い合わせ先／組み込みソリューション本部 <http://www.nexty-ele.com>

2019年6月26日プレスリリース

ネクスティ エレクトロニクスのグループ会社豊田通商先端電子(大連)とC&S Group GmbHが 日系グループ企業として初めて中国CATARCグループと合併会社を設立

ネクスティ エレクトロニクスのグループ会社2社と、中国における自動車の国家基準(GB、GB-T)を唯一策定できる中国汽车技術研究中心有限公司(本社：中国天津市、董事長・総経理：于凱、以下「CATARC」)のグループ会社が車載Ethernetテストサービスの提供を目的とした合併会社を中国常州市に設立しました。

■ 合併会社設立の背景・目的

自動車業界のトレンドであるCASEの領域における技術進化は著しく、新しい技術への迅速な対応が求られている。その中で次世代の車載通信分野においては、通信データの高速化・大容量化に対応可能な車載Ethernetの活用が期待されています。特に車載市場の成長が著しい中国においては、車載Ethernetの標準化及び規格適合テスト、認証スキームの構築が急務となっています。その状況の中、CATARCグループと共に、車載の規格策定から規格適合テスト、認証までのスキームを構築し、中国における車載Ethernetの普及、次世代モビリティの加速・促進に貢献していきます。



■ 新社会併会社概要

■ 合併会社名

中国語名：中汽研睿赛安斯(常州)智能科技有限公司

英語名：CATARC AERI C&S(Changzhou) Intelligence Technology

■ 事業内容

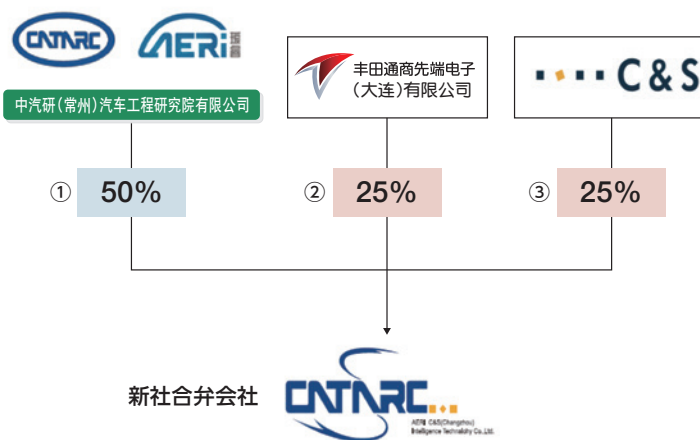
中国市場における車載Ethernetの適合テストサービス

■ 出資構成/比率

- ① 中汽研(常州)汽車工程研究院有限公司(AERI常州)：50%
- ② 豊田通商先端電子(大連)有限公司(ネクスティ大連)：25%
- ③ C&S Group GmbH(C&S)：25%

CATARCグループ

ネクスティグループ：50%



■ 出資会社概要

① AERI常州

本社：中国常州市

代表者：院長 高 継東

事業内容：

CATARCグループのエンジニアリング会社
エンジニアリングサービスの提供、規格策定・
認証支援

② ネクスティ大連

本社：中国大連市

代表者：董事長 伊藤 秀哉

事業内容：

車載関連組み込みソフトウェア開発テスト、
業務受託

③ C&S

本社：ドイツ Wolfenbuttel

代表者：President David Bollati,
Frank Fischer

事業内容：

主に欧州を中心とした、車載通信における
規格適合テスト、コンサルティングサービス

お問い合わせ先／組込みソリューション本部 <http://www.nexty-ele.com>

2019年7月1日プレスリリース

株式会社 ネクスティ エレクトロニクスと半導体製造中止品の継続供給サポートを行う Rochester Electronics, LLCが代理店契約を締結

ネクスティ エレクトロニクスとロチェスターエレクトロニクス(以下、RE®)は、高品質かつ長期間にわたる製造及び供給が求められる分野のセットメーカーに対し、国内外の主要半導体メーカーが製造中止をした半導体製品の継続供給をサポートします。そして、多くのお客様が抱える課題解決につながる新たなソリューションを提案していきます。

■ 本社

正 式 名 称 : Rochester Electronics, LLC
本 社 所 在 地 : 米国マサチューセッツ州ニューベリーポート
1981年設立(株式非公開)
デザインセンター : 米国メリーランド州ロックビル、ミネソタ州バーンズビル
営 業 本 部 : イギリス、シンガポール
営 業 オ フ ィ ス : 米国、日本、ドイツ、中国

70社以上の主要半導体メーカーより認定された、半導体製品を継続供給する業界最大手の正規販売代理店および製造メーカー

■ 日本オフィス

所 在 地 : 東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60ビル
代 表 : 藤川 博之
URL: www.rocelec.jp



本社

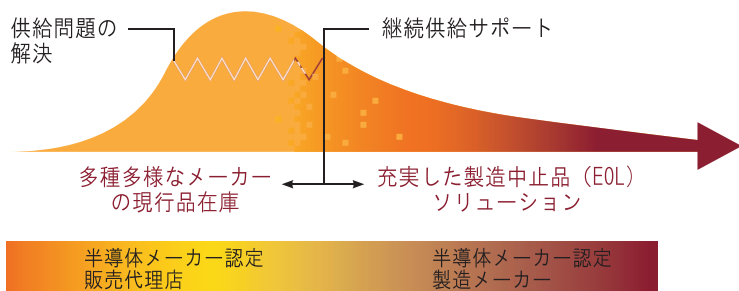
■ 在庫販売

- RE®はメーカー認定の正規販売代理店として、150億個以上の在庫と20万種類以上の製品群を持ち、世界最大規模の製造中止品(EOL)及び現行品を供給しています。

■ 継続生産/再生産

- RE®はメーカー認定の製造メーカーとして、ダイ換算で120億個以上のウェーハ在庫を持ち、7万種類を超える製品展開が可能、また今までに2万種類以上の製品製造実績があります。

私たちの理念 半導体製品の安定供給へ



取
組
紹
介

お問い合わせ先／プロダクトマーケティングユニット nexty_rochester@nexty-ele.com

ネクスティ エレクトロニクス2019年上半期新拠点のご紹介

韓国法人



法人 理事 丁 海鐘

■ごあいさつ

アンニョンハセヨ! 韓国法人は今年の3月に設立し、韓国豊田通商エレクトロニクス部のメンバーとビジネスを継承し立ち上げ、4月よりNEXTYグループの一員になりました。総員7名の体制で車載半導体輸入や韓国商材輸出を主要ビジネスとしており、100年に一度と言われている自動車領域の大きな変化の中、当地の数多い中堅・ベンチャー企業とのパートナーシップを構築し優れた技術・商材をNEXTYグループの総合力で付加価値を上げグローバルへ展開していく事を使命として取り組んでおります。海外出張の際にはぜひ仁川空港トランジットでソウルへお立ち寄りください。

■特長・強み

地理的には本社から一番近い海外拠点です。東アジア極に属し日本・中国といった巨大市場を持ちます。また、国内では約403万台の自動車生産台数を持つ自動車市場であるとともに、自動運転・コネクテッド・電動化の分野において、世界トップクラスの家電・半導体メーカーが次世代自動車産業への参入に取り組んでおり、対内外的に市場・商材が揃い、NEXTY韓国として当社ならではのビジネスモデルを作っていきたいと考えています。

■拠点概要

商 号：TOYOTA TSUSHO NEXTY ELECTRONICS KOREA CORPORATION
所 在 地：30F, Mirae Asset CENTER 1 West Tower, 26, Eulji-ro 5-gil, Jung-gu, Seoul 04539, Korea
代表理事：吉川 伸一
従業員数：7名(2019年4月時点)
事業内容：半導体及び電子部品の販売
株主構成：ネクスティ エレクトロニクス 75%
TOYOTA TSUSHO KOREA 25%
資 本 金：28億ウォン(日本円 換算 約2億8,000万円)
開 設 日：2019年3月



上海法人 天津支店



天津支店は駐在員1名とローカルスタッフ6名がオート領域を中心として活動しています。天津を拠点として、さらに華北全域(特に北京・大連等)に拡大、注力して参ります。電子部品の販売だけでなく、特にCASE領域において、パートナー探索やエンジニアリング支援など、新規ビジネスの創造に挑戦していきます。

■拠点概要

商 号：TOYOTA TSUSHO NEXTY ELECTRONICS SHANGHAI CO., LTD.
TIANJIN BRANCH
所 在 地：11F, Metropolitan Tower, 183 Nanjing Road Heping District, Tianjin China Post:300051
開 設 日：2019年4月1日
事業内容：半導体及び電子部品の販売

ドイツ法人 スペイン支店



NEXTY EUROPE ドイツ本店の下部組織として、駐在員事務所から切り替わる形でスペイン支店が開設しました。バルセロナに拠点を置く地の利を活かし、欧州地域のサポートをしていきます。

■拠点概要

商 号：TOYOTA TSUSHO NEXTY ELECTRONICS EUROPE GmbH Spain Branch
所 在 地：Carrer Cal Pi de l'Olla, 37-39, 08820-El prat de Llobregat, Barcelona, Espana
開 設 日：2019年5月1日
事業内容：スペイン及び周辺諸国への半導体及び電子部品の販売
EMSのご紹介
欧州スタートアップカンパニーの発掘及びご紹介
欧州域外スタートアップカンパニーのご紹介

お問い合わせ先／経営企画部 <http://www.nexty-ele.com>

製品MATRIX

カテゴリ	メーカー名称	半導体										電子部品							モジュール			ボード類、機器、その他		
		マイコン/FP/GW/プロセッサ	ディスクリット	センサー	オプト製品	電源IC	アナログIC	デジタルIC	メモリー	通信IC	MEMS	受動部品	接続部品	ストレージ関連	表示/HMI関連	センサー類	電池類	プリント基板	通信モジュール	パワーモジュール	ボード類	機器	その他	
	Analog Devices Inc.	●		●	●	●	●			●														
	ASMedia Technology Inc.									●														
	Elite Semiconductor																							
	Infineon Technologies AG	●	●	●		●	●			●														
	Maxim Integrated	●		●		●	●			●														
	Micron Technology Inc.												●											
	NEXPERIA		●																					
	NVIDIA Corporation	●																						
	NXP Semiconductors	●	●	●		●	●														●	●	●	
	OSRAM Opto Semiconductors GmbH			●	●																			
	Qualcomm																							
	STMicroelectronics N.V.	●	●	●	●	●	●		●		●													
	TDK MICRONAS GmbH	●		●																				
	Texas Instruments Incorporated	●		●		●	●				●													
	Techpoint, Inc.																							
	VISHAY Intertechnology, Inc.		●	●	●		●	●				●										●	●	●
	Xilinx, Inc.	●																						
	ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社			●							●													
	愛知製鋼株式会社			●																				
	AU Optonics Corporation														●									
	Career Technology (Mfg.) Co.,Ltd.												●					●						
	Dynamic Electronics												●					●						
	Kinwong Electronic		●				●	●		●								●						
	Maestro Wireless Solutions Limited																●					●		
	NEC Energy Solutions, Inc.																							
LEM Holding SA																								
Rayben Technologies															●		●							
RECOM Power GmbH																			●					
Seagate Technology													●											
Sierra Wireless Inc.																		●						
Toyo Aluminium K.K.			●																					
TTM (Viasystems)																	●							
u-blox AG			●				●												●					
Unimicron																								
Yes Optoelectronics Co.,Ltd.														●										
新電元工業株式会社		●			●	●																		
新日本無線株式会社						●	●																	
積水ポリマテック株式会社																								
日本シイエムケイ株式会社																							●	

取扱製品一覧

半 導 体

Analog Devices Inc.

高性能アナログ半導体(ADC、DAC、AMP、電源 etc)、オーディオ/ビデオIC、DSP、各種センサー、他

ASMedia Technology Inc.

デジタル高速インターフェイスSATA、PCI Express、USB3.0/3.1コントローラー、Hub、マルチプレクサ製品

Elite Semiconductor Memory Technology Inc.

低容量DRAM(SDRAM/DDR1/DDR2/モバイルSDRAM/モバイルDDR)、NAND型フラッシュメモリー及びNANDベースのMCP、SDRAM、DDR1、DDR2のKGD製品

Infineon Technologies AG

P10

車載用半導体(レギュレーター、DC/DC、ハイサイドSW、ローサイドSW、FET、ブリッジ、GMR、ホールセンサー、Driver IC、CAN、LIN)、32bitマイクロコントローラー(ARM)、パワーデバイス(高耐圧パワーMOSFET、低電圧パワーMOSFET、電源制御IC、IGBT、IBGTモジュール)、IPM、高周波ディスクリット(移動体通信)、NFC、TPM、Chip Card & セキュリティ製品、大気圧センサー

Maxim Integrated

P14

セキュアマイコン、認証IC、生体センサー、ジェスチャーセンサー、ガスセンサー、1-wire、SerDes、I/O LINK、大電流電源IC、データコンバーター、オペアンプ、インターフェイス、RF IC、バッテリー管理IC、チューナーIC、リファレンス、光トランシーバー、パワーマネージメント、センサー、スイッチ・マルチプレクサー、クロック及び発振機、高耐圧電源IC

Micron Technology Inc.

DRAM、LPDRAM、DRAM Module、NOR Flash、NAND Flash、eMMC、MCP(NVM+RAM)、PCM、SD Cards、SSD

NEXPERIA B.V

ロジックIC、MOS-FET、小信号トランジスター、ダイオード

NVIDIA Corporation

P9

GPU、SoC(自動運転プラットフォーム、組み込みプラットフォーム、ディープラーニング学習コンピューター、各種ソフトウェア)

NXP Semiconductors

P3~8

【オートモーティブ】マイクロコントローラー/プロセッサ、セーフティ・ボディ・パークトレン・セーフティ向けASSP、カーオーディオ用DSP、カーチューナー専用IC、車載ネットワーク用IC(FlexRay、CAN、LIN、SBC)、各種センサー、キーレスエントリー/モビライザー/MOSFET、RF、パワーマネージメントIC
【マルチマーケット】ARMマイコン、NFC、各種I²Cバス用IC、電源コントローラーIC、RFディスクリット、RTC、LEDドライバー・コントローラー

OSRAM Opto Semiconductors GmbH

面実装LED、赤外発光素子、半導体レーザー

Qualcomm

Bluetooth、WiFi、GNSS、等通信系半導体

STMicroelectronics N.V.

車載向けIC

8bit(自社)/32bit(PowerPC、ARM)マイコン、ボディ・パークトレン・セーフティ向け各種ASSP、GNSS、オーディオパワーアンプ、チューナーIC、MOSFET、IGBT、ダイオード、LEDドライバー、レギュレーター、EEPROM、セキュアメモリー、モーションMEMSセンサー、高精度オペアンプ/コンパレーター/電流センスアンプなど、ミリ波レーザー用MMC、CMOSイメージセンサー

非車載向けIC

8bit(自社)/32bit(ARM)マイコン、セキュアマイコン、メモリ(EEPROM)、モーションMEMS、環境センサー、ToF測距センサー、MEMSマイク、アンプ&コンパレーター、RF(BluetoothLE、NFC、Sub GHz帯、PLLシンセ他)、モータードライバー、LEDドライバー、MOSFET、IGBT、ダイオード、トリアック、サイリスタ、電源用IC(AC/DC、DC/DC、チャージャ等)、USB PD、I/Oリンク、保護素子、シリコンフォトニクス、プロセスファウンダリ

TDK MICRONAS GmbH

リニアホールセンサー、ホールスイッチ、360度角度センサー、3相BLDCドライバー内蔵12V直結8-bitマイコン、デジタル出力の電流トランスデューサー

Techpoint, Inc.

映像伝送インターフェイスIC(HD-TVI)、LCDコントローラー、アナログビデオコーダー

Texas Instruments Incorporated

アンプ、オーディオ、クロックタイミング、データコンバーター、DLP®製品、インターフェイス、アイソレーション、ロジック、モータードライバー、電源IC、組込みプロセッサ、RF Blue ToothLE、SubGH帯、ミリ波、センサー製品、スイッチ/マルチプレクサ、ワイヤレス・コネクティビティ

VISHAY Intertechnology, Inc.

P13

シリコニクス(パワーMOSFET、アナログスイッチ、パワーIC、スマートロードスイッチ)、ダイオード製品(パワーダイオード、整流素子、サージ吸収素子、ブリッジダイオード)、オプトエレクトロニクス製品(赤外線受光素子、IrDA製品、近接・照度センサー)受動部品(インダクター、精密抵抗、巻線抵抗、面実装型パワー抵抗、MELF抵抗、大容量コンデンサ、フィルムコンデンサー、ハイブリッドコンデンサー、タンタルコンデンサー)

Xilinx, Inc.

FPGA、Logic製品(Spartan6、Artix7)、ARM Coreを内蔵したMPSOC(Zynq Ultra Scale+)

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

CMOSイメージセンサー、インターフェイス(Gigabit Video Interface)

愛知製鋼株式会社

地磁気センサー(MIセンサー)

電子部品

ボード類・機器・その他

AU Optronics Corporation

液晶ディスプレイパネル(産機、車載、アミューズ、サイネージ向け等)、タッチパネル

Career Technology (Mfg.) Co., Ltd.

FPC、リジッドフレキ

Dynamic Electronics

両面~8層貫通基板、Semi Flex基板、Rijid Elex基板、厚銅多層基板、HDI基板、高周波対応積層基板

Kinwong Electronic

金属基板(AL、銅)、銅インレイ、両面~8層多層基板、厚銅多層基板

LEM Holding SA

高性能電流センサー、電圧センサー

Maestro Wireless Solutions Ltd.

P11~12

IoT/M2M ゲートウェイ、モデム、GPSTラッカー、LoRaWAN各種端末、LTE Cat.4、Cat.1、Cat.M1、NB-IoT、2G/3G ファールバック、海外認証サポート

NEC Energy Solutions, Inc.

産業用リン酸鉄リチウムイオン二次電池
12V 5Ah仕様: ALM12V7s、ALM12V7sHP
12V 35Ah仕様: ALM12V35s、ALM12V35i HP CAN bus、ALM12V35i HP SMBus

Rayben Technologies

セラミックインレイ基板、金属基板(アルミ、銅)、両面~8層多層基板

RECOM Power GmbH

DC/DCコンバーター、AC/DCコンバーター、スイッチングレギュレーター、LEDドライバー

Seagate Technology

ハードディスクドライブ(HDD)、PCIe SSD、SAS SSD、ストレージシステム

Sierra Wireless, Inc.

広域無線通信(LTE/UMTS/HSDPA、Edge/GPRS、EV-DO/CDMA)モジュール、M2Mソリューション

Toyo Aluminium K.K

AL RFID/AL+PET FPC/AL+PI FPC/CU+PI FPC/電磁波シールド/導電性接着剤/導電性ペースト/ALペースト伸縮配線板/AL箔インサート成形品

TTM (Viasystems)

4層~10層貫通基板、厚銅多層基板

u-blox AG

GNSSセンチメートル級高精度測位(SSR-RTK/2周波)、マルチGNSS(GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo対応)レシーバーIC及びモジュール製品、推測航法ソリューション(3Dセンサー内蔵モジュール等)、OSR-RTKモジュール、eCall/ERA-GLONASS対応ワイヤレス通信モジュール(GSM/GPRS、UMTS/HSPA+、LTE Cat. NB1/M1/1/4/6/9/16/19、5G)、近距離無線モジュール(Bluetooth classics/Bluetooth low energy/Bluetooth 5、WLAN、11a/b/g/n/ac/ax、V2X向け、11p)

Unimicron

両面~8層貫通基板、Semi Flex基板、Rijid Elex基板、銅インレイ基板、厚銅多層基板、HDI基板、高周波対応積層基板

Yes Optoelectronics Co. Ltd

カスタムLCDパネル(LCDタイプ:TN、HTN、STN、FSTN、DSTN、DFSTN、ESTN、ASTN、VA、FS)、モノクロTFTパネル、カラーTFTパネル、バックライトLEDモジュールなど

新電元工業株式会社

ダイオード、FET、バリスタ、電源モジュール、サイリスタ、IGBT

新日本無線

各種半導体(オペアンプ/コンパレーター・電源IC・オーディオ/ビデオIC・他)

積水ポリマテック株式会社

静電容量タッチスイッチセンサーシート、放熱シート、樹脂成型、ラバー成型

日本シイエムケイ株式会社

プリント配線板

ネクスティ エレクトロニクス企画製品

自社開発製品

新たなサイネージシステム スマートコムサイネージ®
クラウド型配信システム連動、屋外/屋内対応

Back number



NEW vol.170 JAN 2018

特集企画：海外特集 第一弾

- ・世界に広がるネクスティをご紹介します
- ・半導体市場の成長とネクスティ エレクトロニクス
- ・ひと目で分かる世界の地域別半導体 デザイン額・購入額
- ・各国・地域の基本情報①
- ・各国・地域の基本情報②
- ・各国・地域の基本情報③



NEW vol.171 APR 2018

特集企画：海外特集 第二弾

- ・ネクスティ エレクトロニクス 豪亜極のご紹介
- ・シンガポール法人
- ・マレーシア法人
- ・フィリピン駐在員事務所
- ・インドネシア法人
- ・インド法人
- ・タイ法人
- ・メキシコ法人



NEW vol.172 JUL 2018

特集企画：海外特集 第三弾

- ・ネクスティ エレクトロニクス東アジア極のご紹介
- ・香港法人 ・深セン法人
- ・上海法人 ・大連法人
- ・台湾法人 ・広州法人
- ・成都法人
- ・ネクスティ エレクトロニクス欧州極のご紹介



NEW vol.173 OCT 2018

特集企画1：NVIDIA

- ・NVIDIA ～Leader in AI Computing～
- ・自動運転戦略 End to End システムソリューション
- ・自動運転開発プラットフォームトータルソリューション
- ・ディープラーニング学習サーバー DGXシリーズ
- ・Jetson Xavier 遂に当社から販売開始!
- ・産業モビリティ向け自動運転ECUシステム提案
- ・Maxim Integrated社 完全自動運転システムに向けたMaxim社のアプローチ
- ・Micron Technology社 Micron社製 SSDラインナップのご案内

特集企画2：e-NETV

- ・スペシャル対談 担当役員が語るe-NEXTY立ち上げの想い



NEW vol.174 JAN 2019

特集企画：インフィニオン テクノロジーズ

- ・対談 共に成長してきた15年来的パートナー
- ・自動運転化などによる更なる事業成長
- ・パワーマネジメント&センサーテクノロジー具現化への挑戦
- ・エネルギーの効率的な消費を推進
- ・IoT社会実現に向けた組込みセキュリティの提案



NEW vol.175 APR 2019

特集企画：マキシム・ジャパン

- ・「2019年度の展望」～マキシム・ジャパン 新社長 林孝浩氏に聞く～
- ・製品紹介 GMSL(SerDes) サポート体制
- ・製品紹介 脈波センサーによるヘルスケアソリューション
- ・製品紹介 Himalaya uSLIC パワーモジュール
- ・マキシム会社概要と当社のグローバル展開



NEXTY ELECTRONICS WORLD

バックナンバーのダウンロードはこちらから

次の未来へ。



株式会社ネクスティ エレクトロニクス

- 東京本社(本店)** 〒108-8510 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル
TEL:03-5462-9611 FAX:03-5462-9690
- 名古屋本社** 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-27 シンフォニー豊田ビル
TEL:052-558-4100 FAX:052-561-1761
- 大阪支店** 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-3-11 大阪豊田ビル
TEL:06-6243-6611 FAX:06-6243-6701
- 仙台営業所** 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー
TEL:022-221-8061 FAX:022-221-8055
- 松本営業所** 〒390-0815 長野県松本市深志2-5-26 松本第一ビル
TEL:0263-34-6131 FAX:0263-34-6130
- 神戸営業所** 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8-3-5 明治安田生命神戸ビル
TEL:078-272-1660 FAX:078-272-1770
- 福岡営業所** 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-2-5 紙与博多ビル
TEL:092-436-4001 FAX:092-436-4002
- 商品センター** 〒207-0021 東京都東大和市立野4-495
TEL:042-846-0001 FAX:042-846-0101
- VAセンター** 〒207-0021 東京都東大和市立野4-495
TEL:042-846-0088 FAX:042-846-0099
- TAQSセンター** 〒446-0004 愛知県安城市尾崎町大縄1-3 豊通物流ビル
TEL:0566-96-4433 FAX:0566-97-3467

